

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 2 年 12 月 17 日 (2020.12.17)

【公開番号】特開 2019-176158 (P2019-176158A)

【公開日】令和 1 年 10 月 10 日 (2019.10.10)

【年通号数】公開・登録公報 2019-041

【出願番号】特願 2019-81610 (P2019-81610)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/301 (2006.01)

C 0 9 J 7/38 (2018.01)

C 0 9 J 7/30 (2018.01)

C 0 9 J 201/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/78 M

C 0 9 J 7/38

C 0 9 J 7/30

C 0 9 J 201/00

【手続補正書】

【提出日】令和 2 年 10 月 30 日 (2020.10.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基材フィルムと、前記基材フィルムの少なくとも一面側に形成された粘着剤層とを有する粘着テープを有し、

前記基材フィルムは、アイオノマー樹脂を除く熱可塑性架橋樹脂からなり、

前記粘着テープは、M D 方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した 40 ~ 80 の間の 1 毎の熱変形率の平均値と、T D 方向における熱機械特性試験機により昇温時に測定した 40 ~ 80 の間の 1 毎の熱変形率の平均値との和がマイナス値であることを特徴とする半導体加工用テープ。

【請求項 2】

前記粘着剤層側に、接着剤層が積層されていることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体加工用テープ。

【請求項 3】

フルカットおよびハーフカットのブレードダイシング、レーザーダイシング、またはレーザーによるステルスダイシングに用いられることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の半導体加工用テープ。